

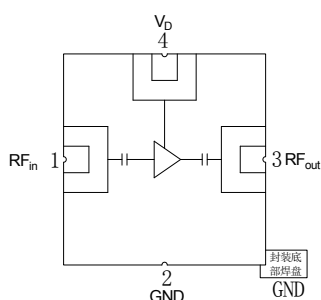
特点:

- 频率范围: 50~90MHz
- 功率增益: 典型值 19dB
- 低噪声系数: 典型值 2.0dB
- SMT 封装
- 尺寸: 8.13*8.13*2.1mm (不含引脚)

性能参数: (50Ω系统, $T_A = -55 \sim +85^\circ\text{C}$)

参数名称	符号	测试条件	参数值			单位	备注
			MIN	TYP	MAX		
频率范围	f	$V_{cc} = +5.0\text{V}$ $Z_{in} = Z_{out} = 50\Omega$ $f = 50 \sim 90\text{MHz}$	50		90	MHz	
功率增益	G		18	19	20	dB	
增益平坦度	ΔG			1	2	dB	
输入驻波	VSWR _I			1.7:1	2.2:1		
输出驻波	VSWR _O			1.6:1	2.0:1		
噪声系数	NF			2.0	2.8	dB	
反向隔离度	IR			17	21	dB	
输出-1dB 压缩点	OP-1dB			+5.0	+6.5	dBm	
输出三阶截点	OIP3			+15	+20	dBm	
电源电压	V _D			+4.75	+5.00	+5.25	V
工作电流	I _D			17	21	mA	
工作温度	T		-55		+85	°C	
质量	m				2	g	

功能框图:



极限参数表:

参数名称	极限值
输入射频功率	+10dBm
电源电压	0~+6V
装配温度	+230°C, 20s
工作温度	-55~+85°C
贮存温度	-55~+100°C
静电放电敏感度等级	1A

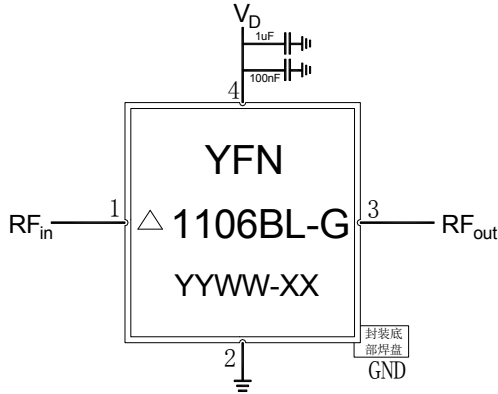
超过以上任何一项极限参数, 可能造成器件永久损坏。

引脚定义:

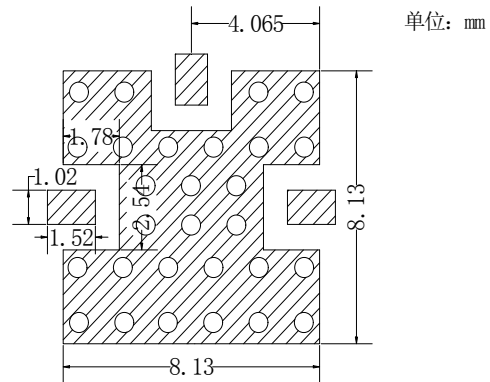
引脚编号	符号	描述
1	RF _{IN}	射频输入端口, AC 耦合
3	RF _{OUT}	射频输出端口, AC 耦合
4	V _D	电源供电端口
2/外壳	GND	接地



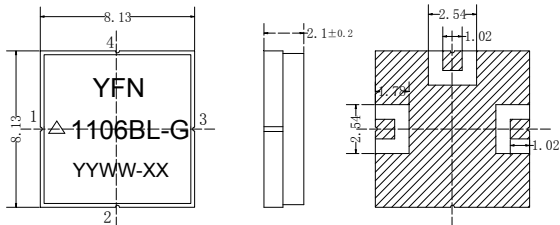
推荐外围电路:



推荐焊盘:



外形尺寸图:



字符标志:

标识	说明	备注
YFN1106BL-G	产品型号	
△	1脚&静电敏感标识	
YYWW	批次号	
XXX	序列号	

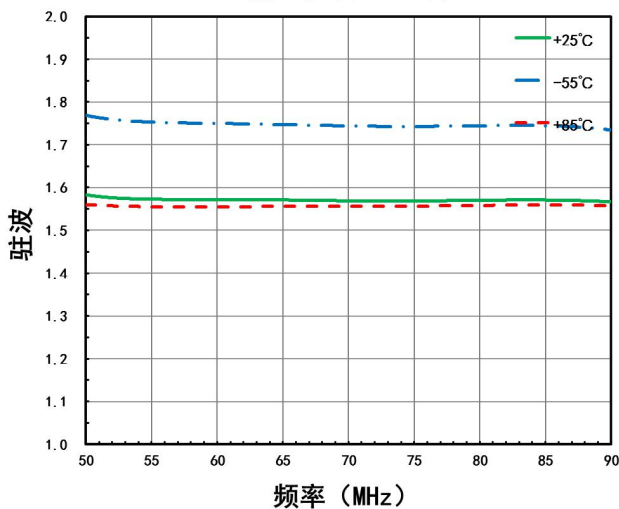
注: 1、单位: mm, 未注明公差按±0.15mm;

2、产品采用气密陶瓷封装, 引脚表面镀镍金
(Ni:1.3~8.9um, Au:1.3~5.7um);

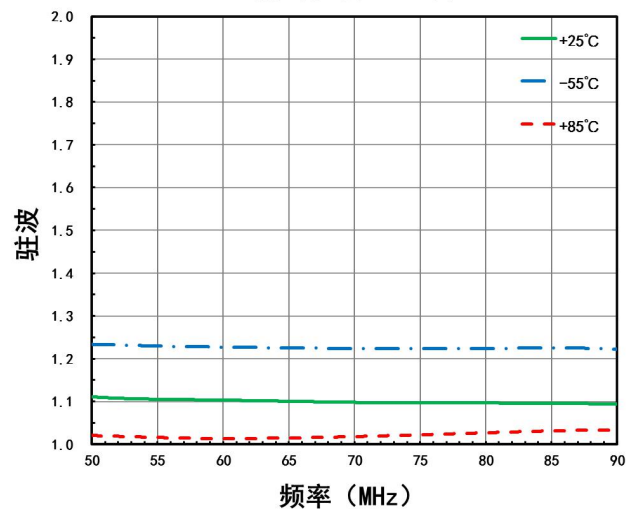
3、产品标识采用激光刻字。

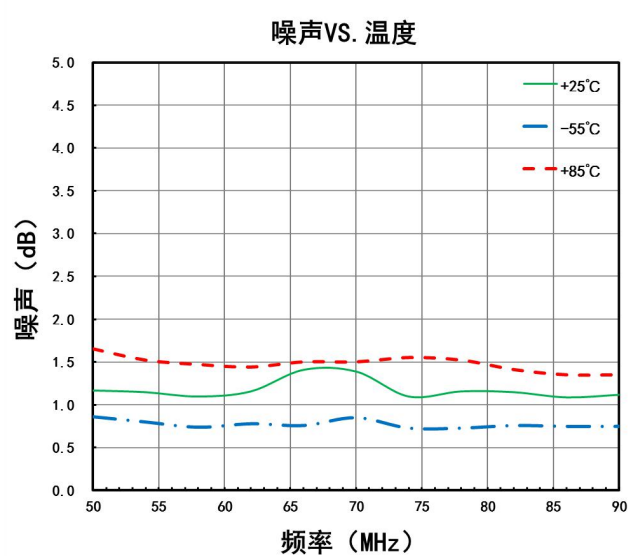
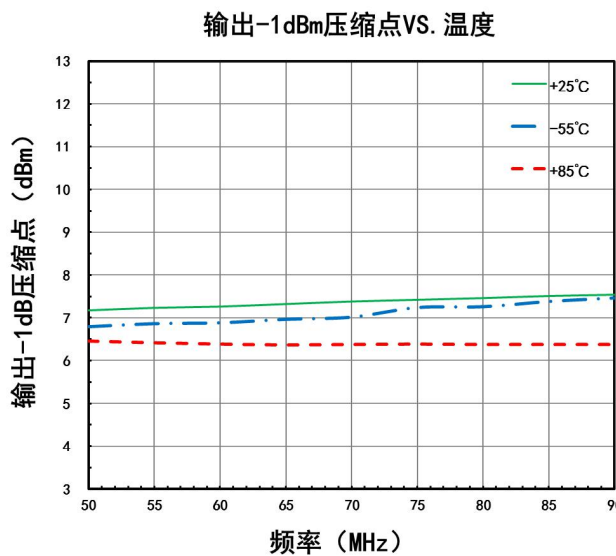
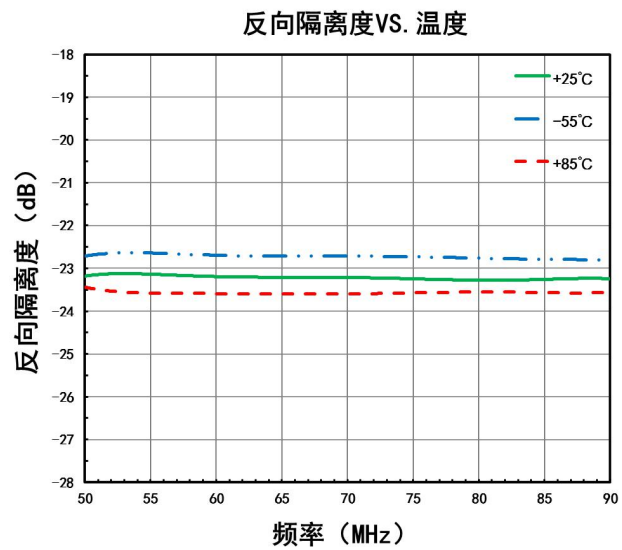
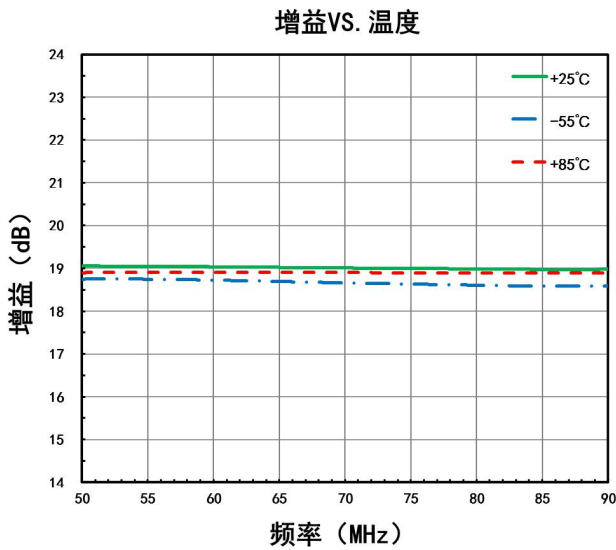
典型测试曲线: (50Ω系统, V_D=+5V, P_{IN}=-30dBm)

输入驻波VS. 温度



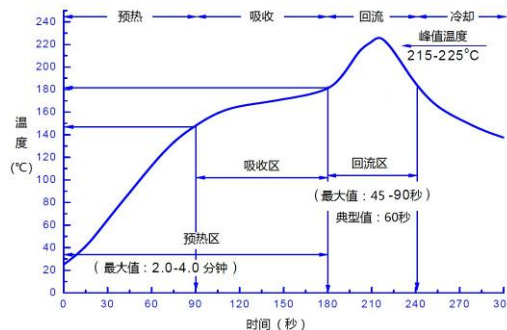
输出驻波VS. 温度





产品使用注意事项:

1. 产品属于静电敏感器件，产品在运输、装配使用过程中请注意静电防护；
2. 产品使用时请保证接地良好（GND 引脚和底部金属化区域）；
3. 产品推荐采用 SMT 工艺贴片使用，采用 Sn63/Pb37 锡膏，熔点+183°C回流焊接，回流温度推荐曲线。



此图为推荐回流温度曲线，因基板及回流焊设备性能不同而有所差异。请依据使用的基板与回流设备确认实际温度曲线，实测回流基板温度不得超过极限参数中的装配温度。

4. 如特殊情况需采用手工补焊，烙铁温度+350°C，焊接时间不超过 3 秒；回流及手工焊接次数不大于 3 次。
5. 产品在存储时需采用防静电托盘或防静电袋进行密封包装，存放条件：温度+10~+35°C，湿度 35~65%RH；对于需长期储存（超过半年）产品尽量在充氮干燥环境下存放。
6. 客户在产品应用时应结合实际环境考虑是否对产品进行防护处理。对有盐雾防腐等要求的环境，客户在对产品焊接及清洗完成后，应对产品进行三防喷涂处理，以提高产品耐环境适应性能力。